

■ 貴金属ろう

● 低融点Auはんだ



特徴

主に通信機器などの封止には、
低融点のAu合金はんだが用いられています。

低融点Auはんだの物理特性(参考値)

	固相点(°C)	液相点(°C)	密度 (g/cm ³)
80Au-Sn	280	280	14.5
88Au-Ge	356	356	14.7

● CdフリーAgろう



特徴

ステンレスや伸銅品など各種金属部品の接合に使用され、
様々な工業分野で広く使用されています。
当社製品には、人体に有害なカドミウムは使用されておりません。

CdフリーAgろうの物理特性(参考値)

	Ag%	固相点(°C)	液相点(°C)	ろう付け温度(°C)	密度 (g/cm ³)	引張強さ (MPa)	伸び(%)	対応JIS No.
SS-1	72	780	780	780~900	10.0	290	20	B _{Ag} -8
SS-14	56	620	650	650~760	9.2	450	20	B _{Ag} -7
SS-19	40	670	780	780~900	8.8	500	25	B _{Ag} -4
SS-20	50	690	775	775~870	9.3	450	26	B _{Ag} -6
SS-520	52	634	690	690~800	9.1	450	28	-
SS-671	68	790	800	800~900	10.0	290	20	-

材質・形状・寸法に関しては、ご要望に応じて対応致します。